

2022年8月4日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード市場)
代表者名：代表取締役 姜 輝
問合せ先：専務取締役 樋口 真康
(TEL：045-317-7888)

資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、2023年1月13日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当の方法による第11回新株予約権の発行について、2023年6月末までにすべて本新株予約権の行使が完了し、調達予定手取金概算額：498,114,000円のところ、調達金額は430,088,200円となりました。そのため、調達予定金額に関し、乖離が発生しましたので、下記のとおりその資金使途の一部を変更する決議を本日の取締役会にて行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

2022年末まで世界を翻弄した新型コロナ禍も一段落し、世界はウイズコロナ、アフターコロナに向かって進み始めました。当社は半導体市場成長の著しい中国、そしてそれら半導体のデザインハウスの多い台湾方面をメイン市場と捉え、新機能の充実を目的に主力検査装置の更なる競争力アップ、営業力拡大を意図し、業績の向上を目的に2023年1月13日に公表いたしましたとおり、GFA株式会社を割当先とする第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行を行うことを決議し、その資金使途として、当時特に不足していた一部半導体部材の仕入れ並びに、次世代装置の開発や技術者の増強、それに伴う大阪事業所の移転増強並びに増加運転資金としてまいりました。

それらの資金充当に関し、主な変更を行う理由に関しまして、調達資金が7千万円近く減少したことから、経費の削減に取り組んでまいりましたが、減少額が大きいため計画の一部を取りやめることといたしました。また、それまで半導体市場をけん引してきたテレワーク需要などが終息に向かい、2022年秋頃から顕在化してきたPCやスマホ、一部情報端末機器向け需要が大幅に減速し、特にPCやスマホ関連の半導体が想定以上にダブつくこととなり、顧客の設備投資が急減速したことを背景に、計画していた受注が遅れることとなったため、営業戦略の見直しを行い、資金使途の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

資金用途の変更の内容は以下のとおりであります。（変更箇所は下線で示しております。）

(変更前)

	具体的な用途	金額（円）	充当予定時期
①	装置製造に関わる半導体部材仕入れ等	<u>130,000,000</u>	<u>2023年1月～2023年10月</u>
②	<u>次世代先端システム開発費、バリエーション展開</u>	<u>100,000,000</u>	2023年1月～2023年12月
③	<u>技術者増強(技術営業、開発、サポート)</u>	<u>100,000,000</u>	2023年3月～2024年12月
④	<u>製造工場移転増強</u>	<u>70,000,000</u>	2024年3月～2025年12月
⑤	その他運転資金	<u>98,114,000</u>	2023年1月～2024年12月

(変更後)

	具体的な用途	金額（円）	充当予定時期
①	装置製造に関わる半導体部材仕入れ等	<u>70,000,000</u>	<u>2023年1月～2023年12月</u>
②	<u>次世代先端システム研究開発費 バージョン1</u>	<u>30,000,000</u>	<u>2023年1月～2023年8月</u>
③	<u>技術者増強(技術営業、開発、サポート)</u>	<u>70,000,000</u>	<u>2023年1月～2023年8月</u>
④	<u>当社100%子会社（ウインテスト武漢）への一括貸付（拠点移転費用、資材購入、運転資金）</u>	<u>120,000,000</u>	<u>2023年8月</u>
⑤	その他当社運転資金	<u>140,088,200</u>	<u>2023年1月～2023年8月</u>
	合計	¥430,088,200	

(変更前) ①で予定していた装置製造に関わる部材仕入れは、2023年上半期までの市場低迷が大きく響き、新規受注が低迷したため、製造部材在庫を見直し、減少させております。（変更前）②次世代先端システム開発関連は一部を前倒しし、バージョン1（※注参照）とバージョン2（※注参照）に分け、今期はバージョン1のみに集中する戦略を取り予算の縮小をします。なお、（変更前）③で計画していた開発・サポート技術者の増強に関し、変更後は、規模を縮小し、若干名を補充することとどめ、引き続き、2024年度以降の予算で行うこととしております。（変更前）④で計画していた、大阪工場の移転につきましては、調達予定資金が予定金額に届かなかったことで、今回の増資資金では移転が難しいと判断、2024年以降に再度計画することとし、延期といたしました。しかし、中国における顧客サポートの多様化への対応と、顧客要求への即応性ニーズが今後の当社事業へ重要になると判断し、当社100%子会社であるウインテスト武漢の営業・サポート拠点の移転並びに、武漢工場における新規開発装置向け部材の購入他で、当社子会社への貸付を行います。（変更前）⑤の運転資金に関しましては、想定以上の諸物価の高騰などの影響を受けて（変更後）⑤のように増加することとなりました。

※注 バージョン1 次世代信号発生器を完成させ、既存筐体に組込み機能をアップさせたもの
バージョン2 次世代信号発生器並びに信号取り込み、筐体すべてが新開発品となる装置

3. 今後の見通しと影響

本変更が、当社グループの2023年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後開示すべき変更などが発生した場合は別途開示いたします。

以上